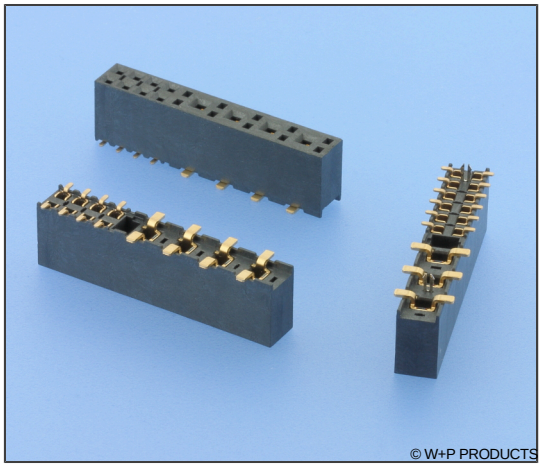
3970

SMT-Buchsenleisten RM 5,08/2,54mm – Power/Signal-Kontakte, durchsteckbar

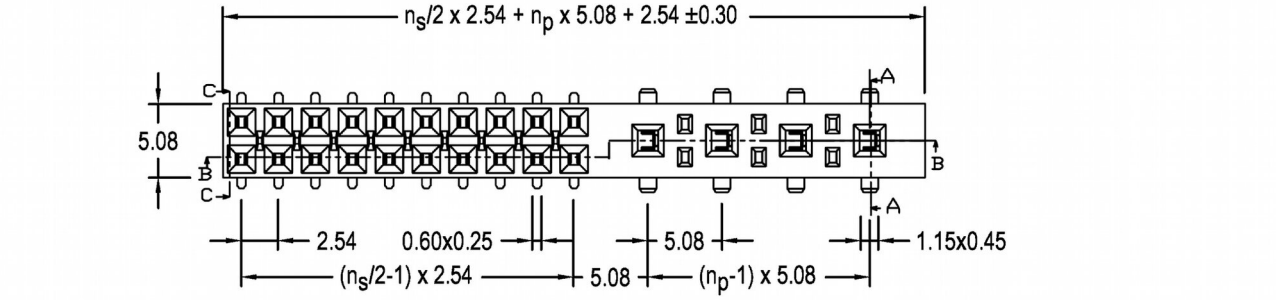
SMT Female Headers, 5.08/2.54mm Pitch – Power/Signal Contacts, Pass Through

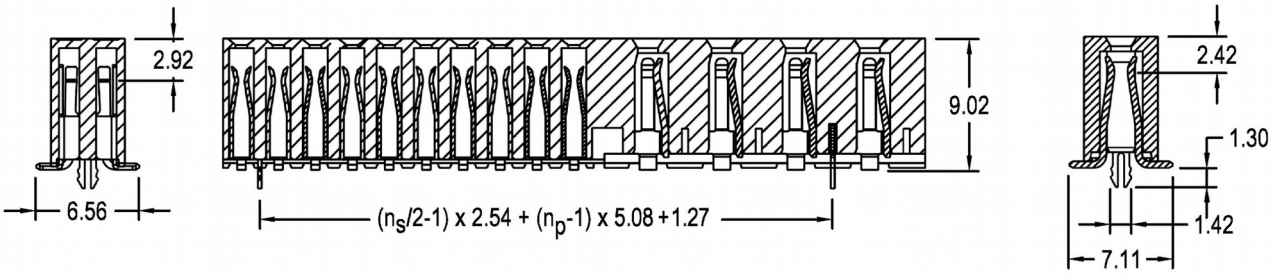
Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options, over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*none*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	*> 500 MΩ*
Spannungsfestigkeit	850 V AC
Withstanding Voltage	*850 V AC*
Nennstrom	3 A / 8,2 A
Current Rating	*3 A / 8.2 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +105 °C*
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	*Reflow soldering*



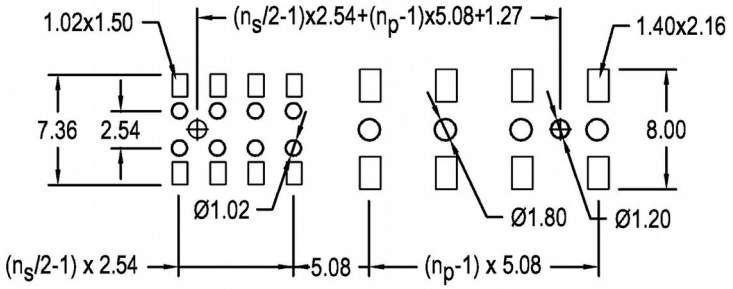
Passende Stiftleisten:
Compatible Pin Headers:
987 9870





SECTION C-C SECTION B-B SECTION A-A

Recommended PCB Layout



Series	*Signal Contacts**	*Power Contacts**	*Board Locks**	*Plating (Signal)**	*Plating (Power)*	*Packaging**
3970	**20**	**04**	**10**	**50**	**50**	**ST**
	04-48	**02-04**	**00** Ohne Board Locks *W/o board locks* **10** Mit Board Locks *With board locks*	**00** Vergoldet *Gold plated* **50** Verzinnt *Tin plated* **60** Sel. Au/Sn	**50** Verzinnt *Tin plated*	**ST** **PPST** **PPTR**

Lieferformen / *Packaging Options:*
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
PPST In Stangen mit PP-Pads / *In tubes with PP-Pads*
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

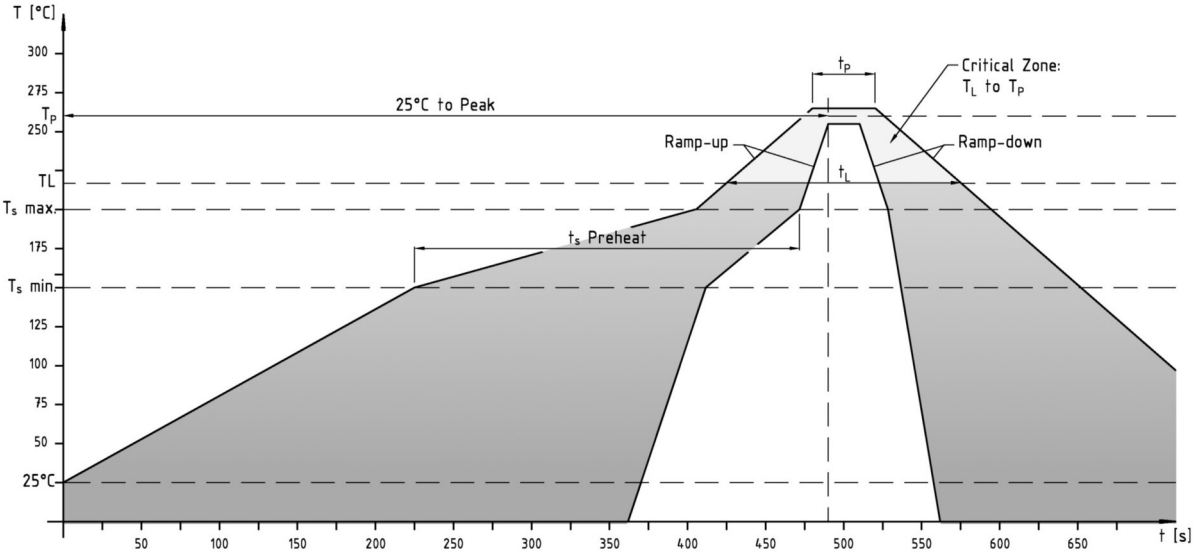
Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*